

1) 保持晶體表面清潔。在使用乾燥和過濾後的空氣或乾氮處理並吹掉任何微粒時，避免與晶體中心作任何實體接觸。保持晶體表面清潔可降低電阻並改善薄膜附著力。

2) 保持與晶體的良好電氣接觸。保持電纜的良好狀況，適當緊貼感測器和饋入裝置。定期檢查感測器頭內的指形彈簧觸點，必要時進行調整或更換。

3) 保持感測器頭蓋清潔。如果在開口周圍積聚的材料接觸晶體，會造成機械耦合和阻尼。

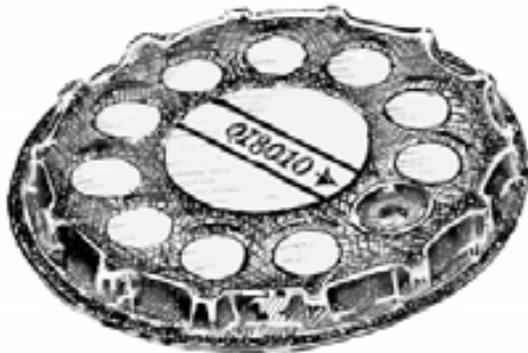
4) 維持晶體感測器的水溫在至少 25°C。當使用具有加熱能力的迴圈冷卻器時，對於高應力塗料，應在 50°C 下運行感測器。較高的溫度可在塗料沈積時，減少應力並改善薄膜/晶體附著力。

5) 對於高應力的材料沈積，用塗有合金的晶體替代黃金。合金電極會在薄膜應力到達晶體表面之前屈服，從而分散薄膜應力。

6) 遮蔽晶體，避免直接暴露在輻射熱源或灼熱下。

7) 在蒸發過程中儘量減少源極「噴濺物」。大片蒸發物（「飛濺物」）將顯著增加晶體電阻，並導致不穩定的速率功能或過早出現故障。在沈積過程中採用適當的源極速率控制、晶體與源極之間的正確距離以及源極類型（例如適用於一氧化矽的 Drumheller 類型），防止由於材料噴出而造成的晶體損壞。

如何改善 晶體性能



Fil-TechInc.

6 Pinckney Street, Boston, MA 02114
www.filtech.com
sales@filtech.com
Call: 800-743-1743
Tel: 617-227-1133
Fax: 617-742-0686